****

* **日期：2021/11/16(二)-17(三)**
* **地點：線上**

**在工業4.0智慧製造的競爭浪潮下，全球製造業正積極往數位轉型、虛實整合的方向邁進，受惠於5G技術革新, 各式各樣的互聯網裝置已加速上市：智慧電動車、智慧家居辦公、智慧醫療遠端照護、以及製造業關注的智慧製造工業互聯網等。**

**Moldex3D致力於發展數位分身Digital Twin技術，協助塑膠射出行業邁向AI數位轉型 智慧智造，2021 Moldex3D Digital Twins用戶高峰會將於2021/11/16(二)~17(三)於線上舉辦，在此誠摯邀請您於本次大會中投稿，對於入選優質技術應用報告，我們邀請您在大會中演講，您和您的企業在技術應用領域之成績，將獲得行業內的肯定認可，誠摯邀請您即刻投稿！**

* **會議流程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **時間** | **主題** | **講者** |
| **2021/11/16(二)** | | |
| **13:10-13:30** | **線上簽到** | |
| **13:30-14:00** | **Moldex3D 工業4.0智慧製造整合發展** | **科盛科技 張榮語 執行長** |
| **14:00-14:30** | **材料數位分身與雲端材料庫** | **科盛科技 許嘉翔 副執行長** |
| **14:30-14:40** | **中場休息** | |
| **14:40-15:10** | **機台數位分身與T0量產** | **科盛科技 彭軼暉 副執行長** |
| **15:10-15:40** | **用戶演講** | |
| **15:40-16:10** | **用戶演講** | |
| **2021/11/17(三)** | | |
| **13:10-13:30** | **線上簽到** | |
| **13:30-14:00** | **iSLM助力協同模具開發與成型知識管理** | **科盛科技 楊文禮 副執行長** |
| **14:00-14:30** | **用戶演講** | |
| **14:30-15:00** | **用戶演講** | |
| **15:00-15:20** | **中場休息** | |
| **15:20-15:50** | **MPE數位學習系統** | **科盛科技 翁文欣 經理** |
| **15:50-16:20** | **用戶演講** | |
| **16:20-16:50** | **用戶演講** | |
| **16:50-17:00** | **閉幕** | |

**(科盛科技保有議程調整權利)**

一張含有 文字, 室內, 桌, 數個 的圖片

自動產生的描述一張含有 文字, 個人 的圖片

自動產生的描述

* **投稿方式：**
  + **歡迎您踴躍投稿，有意投稿者請先完成下頁之”投稿意願表” (2021年10月15日以前截止)**
  + **技術應用報告簡報(PPT)與演講視頻(30分鐘)：請於2021年11月05日前提供**
  + **對於錄取的技術應用報告與演講視頻，我們將提供演講費與獎盃，感謝您及貴單位的參與**

**投稿意願表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名稱** |  | | |
| **演講姓名** |  | **部門** |  |
| **職稱** |  | **公司電話** |  |
| **手機** |  | **E-mail** |  |
| **投稿題目** |  | | |